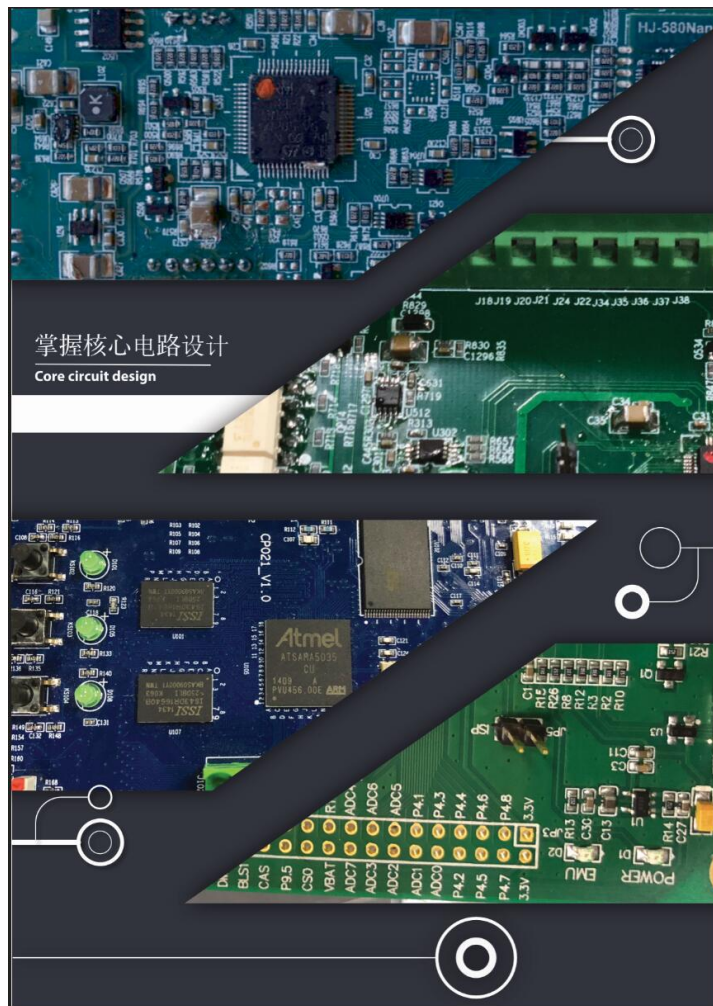




物联网智能硬件电路设计

核心电路板

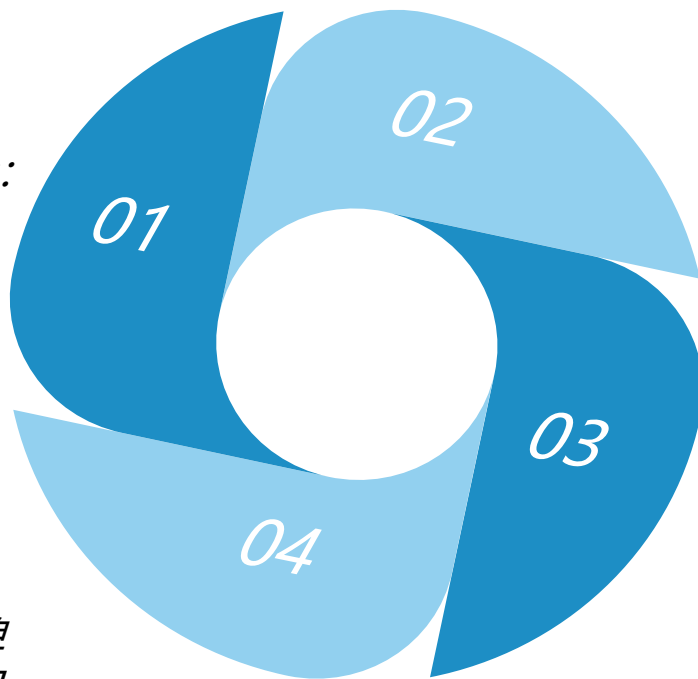


硬件可靠性保障



抗干扰能力强

电磁兼容 (EMC) 设计:
产品达到工业三级标准



环境适应性强

- 宽温设计: 满足 $-40^{\circ}\text{C}\sim 80^{\circ}\text{C}$ 应用环境
- 抗震设计: 通过 $1\text{g}@58\sim 150\text{Hz}$ 标准测试
- 湿度: 满足 $5\%\sim 95\%\text{RH}$ 环境的应用

采用主流元器件

元器件均采用主流品牌的工业级优选物料, 品质保障

生产过程标准化

硬件基于全过程自动化标准生产线完成生产, 硬件生产的可靠性和一致性

性能提升技术



节电技术

基于核心节电控制算法，节电
50%

- ◆ 自动识别通信模式降低功耗
- ◆ 最优数据协议减少通信时间
- ◆ 最大化利用CPU
- ◆ 智能化切换各传感器供电
- ◆ 程序自动控制外设电路供电



容错技术

- ◆ 系统出问题及时修复
- ◆ 系统连续正常运行



远程诊断技术

- ◆ 系统故障时，远程诊断解决，节约维护成本

谢谢观赏